

檔 號：

保存年限：

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 函

地址：744094臺南市新市區南科三路
22號

聯絡人：曾旭廷 簡任秘書

電話：06-5051001分機2529

傳真：

電子信箱：sttseng@stsp.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年5月28日

發文字號：南投字第1130016581號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：本局公開徵求114年度「南部科學園區新興科技應用計畫」，請查照並轉知所屬踴躍提出申請。

說明：

一、依據「國家科學及技術委員會科學園區新興科技應用計畫實施要點」辦理。

二、為激勵科學事業結盟異業或學術界力量，共同從事新興技術研究發展，並促進創新技術人才培育，114年度計畫優先徵求主題如下：

(一)精準健康領域：

1、精準診斷：生物技術結合數位科技，如AI、定點檢測(POCT)、可穿戴診療設備、影像分析、液態檢體或NGS個人化檢測等，應用於疾病診斷與遠距醫療照護。

2、精準治療：發展再生與免疫治療、標靶治療、細胞治療、基因治療、基於微生物組的創新療法等相關產品，及先進核酸藥物、蛋白質降解藥物之精準治療開發平臺。

3、高階醫材：感測醫材關鍵技術、高階影像/診斷醫材元件、微創手術技術、複合材料技術、組織修復醫材、神經組織調節設備、精準給藥系統及高齡科技在精準照護。

(二)智慧機械領域：

1、研發智慧製造關鍵技術與元宇宙應用，如生成式AI、智慧生產、AR/VR、數位孿生、感測融合、自動光學檢測AOI等。

裝

訂

線

- 2、太空關鍵機構零組件、超精密自由曲面開發。
 - 3、開發無人機或智慧載具（無人機、無人(潛)艦、無人車等）相關應用技術。
- (三)新世代積通光電領域(新世代半導體、先進通訊、光電、電腦及周邊)：
- 1、先進半導體製程：垂直封裝及3D堆疊技術、新穎高效能與低功耗晶片技術、高功率散熱材料與模組、矽光子系統及先進半導體檢測技術開發。
 - 2、先進通訊關鍵元件及設備：B5G/6G通訊、雷射光通訊與衛星地面接收等關鍵元件及設備開發。
 - 3、先進資訊系統與技術：AI/大數據、數位轉型服務創新。
 - 4、先進感測元件與模組、Micro LED、車用電子相關技術。
- (四)其他領域：
- 1、淨零科技、綠能減碳技術設備與零組件開發。
 - 2、分散型能源管理與先進儲能技術開發。
- 三、公開徵求期程自即日起至113年7月31日(星期三)下午5時止(郵戳為憑)，計畫執行期間分為1年期及2年期，執行起始日均以114年1月1日起算。
- 四、有意申請本計畫者，請詳閱「申請須知」及「申請手冊」等資料，並逕自本局網站(<https://www.stsp.gov.tw/>)點選「廠商服務>園區獎補助計畫>新興科技應用計畫>相關文件」下載。
- 五、本計畫申請說明會資訊如下：
- (一)時間：113年6月12日(星期三)下午2時至3時。
 - (二)地點：本局高雄園區401會議室(高雄市路竹區路科五路23號)，並同步提供視訊(報名完成將提供會議連結資訊)。
 - (三)邀請對象：南科園區廠商、學研機構人員、其他企業先進及對本活動有興趣之人士。
 - (四)報名方式：請於113年6月11日(星期二)上午10時前完成報名(報名網址為：<https://reurl.cc/nNN018>)。
- 六、計畫諮詢窗口：傅小姐，06-5051001分機2152，ytfu@learnmore.com.tw；李小姐，06-5051001分機2128，tiffany@learnmore.com.tw。

正本：園區廠商(全部)(共274單位)、學研機構(共232單位)、研究機構(共7單位)、台灣科學園區科學工業同業公會南部園區辦事處、社團法人中華民國南部科學園區產學協會
副本：博大股份有限公司-南科辦公室、本局投資組